

# 技術資料

## FP-5023 導電銀膠

### 產品說明：

**FP-5023** 為單液型環氧樹脂導電銀膠接著劑，適用於一般小型半導體晶片黏著。

### 產品特徵：

- 平滑、流體且不拉絲之銀膠。
- 測試金、銀及銅材質不溢膠。
- 對於不同的材質皆有良好之接著性。
- 改善 MSL3 測試之信賴性。

硬化前特性		測試條件	測試方法
比重	3 g/cc	比重計	FT-P001
外觀	銀灰色		
黏度 @ 25°C	9000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	4.8	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
細度	< 20 μm	細度計	FT-P026
水含量	< 0.5 %	水份計	FT-P002
使用壽命 @ 25°C	48hrs	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C	12 個月		FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		60 分鐘 @ 150°C (烘箱烘烤)	
其他烘烤條件		30 分鐘 @ 175°C (烘箱烘烤)	
硬化時之熱重損失	<5%		FT-P010
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	14.0 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (銀支架)	FT-M012
@ 150°C	2.5 kg/die		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

## FP-5023 導電銀膠

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	89°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數	<Tg 44ppm/°C >Tg 212 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數			
@60°C	4491MPa		
@25°C	4085MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@150°C	162MPa		
@250°C	178MPa		
熱/電性質		測試條件	測試方法
體積電阻	0.0001Ω · cm	四點探針	FT-P017
熱傳導係數	3.1W/mK	Hot Disk	FT-P022

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。